

2025/03/04 新聞稿

## 德鑫貳半導體控股宣佈成立

繼 2023 年 7 月由台灣八家半導體供應鏈聯盟廠商成立德鑫半導體控股公司之後，聯盟 2025/02/26 宣布再加入十家新夥伴，準備成立「德鑫貳」半導體控股公司。

面對美國川普政府以及現在整個地緣政治的大變動，台灣半導體供應鏈處在風雨核心，擁有彈性與效率的台灣企業已自行迅速行動，聯盟結合起來集中並互補資源，一起面對這場局勢。身為台灣半導體供應鏈業者，隨著台積電大步邁出海外，大家也加緊佈局，準備迎接前所未有的海外商機。

2023 年 7 月成立的「德鑫半導體控股」，是由迅得機械(6438)、奇鼎科技(6849)、科嶠工業(4542)、家登精密 (3680)、微程式資訊(7721)、聖凰科技、意德士科技(7556)及瀟能(6823)(依公司名稱筆畫排序)共同合資成立，主要是以半導體晶圓製造前段工程設備及耗材的公司為主，這兩年以來八家公司密切地合作，實質產生了許多綜效。

因此聯盟充滿信心，在 2025 年 3 月再加入半導體先進封裝、製程材料以及工業智能應用的十家新夥伴，成立「德鑫貳」半導體控股，德鑫貳半導體控股(股)公司是由友威科技(3580)、印能科技(7734)、邑昇實業(5291)、耐特科技、康淳科技、圓達科技、新應材(4749)、頌勝科技 (7768)、維田科技(6570)、及聯策科技 (6658) (依公司名稱筆畫排序)，再加上原德鑫半導體控股共同合資準備成立。

公司登記完成之後，德鑫兩家控股公司合在一起將有 18 家台灣在地半導體供應鏈的公司，組成半導體供應鏈大艦隊，要一起邁出台灣，駛向海外市場。

德鑫半導體控股大艦隊短期目標可以快速進行海外客戶服務，資源分享並協同行銷，共同分擔海外業務拓展成本。長期目標則可以擴大供給產品應用面，聯盟內部夥伴形成信任圈，合作共同發展新事業項目。

